



PDC 7: 先进封装技术的创新

葛维沪 博士 美国 Pacrim Technology

课程摘要:

过去十年，随着半导体节点工艺接近极限，先进集成电路封装技术发展迅猛。“超摩尔”解决方案对高度复杂的 2.5D 和 3D 封装的设计、材料、互连和制造工艺提出了巨大的创新需求。中国正在打造庞大的后端封装测试产业，要成为世界级的领导者，需要更多新的理念和创新。

本课程将回顾和讨论近期的创新成果，以激励我们的工程师和科学家提出新的思路，推动高性能计算、5G、人工智能和汽车等领域异构集成封装的设计和制造。

课程大纲:

会议范围和概要将涵盖以下领域的设计、材料和工艺创新:

2.5D 基板中介层: CoWoS、CoPoS、CoGoS、CoG

3D IC 集成 HBM 技术

3.5D 封装

FOPLP、FO 玻璃面板工艺

嵌入式桥接互连

玻璃芯片 (CiG)、系统级模块 (SiM)

高密度互连 (HDI) 堆叠和 RDL 材料 – ABF

讲师简介:

葛维沪博士在汉高、摩托罗拉等公司从事集成电路封装和微电子组装技术工作长达 40 年。他是 IEEE 院士，拥有 100 多篇出版物和 40 项专利。他拥有康奈尔大学博士学位。